

四半期報告書

(第50期第3四半期)

自 平成24年10月1日

至 平成24年12月31日



東京エレクトロン株式会社

(E02652)

四 半 期 報 告 書

- 1 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に綴じ込んでおります。

目 次

	頁
【表紙】	1
第一部 【企業情報】	2
第1 【企業の概況】	2
1 【主要な経営指標等の推移】	2
2 【事業の内容】	3
第2 【事業の状況】	4
1 【事業等のリスク】	4
2 【経営上の重要な契約等】	4
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】	4
第3 【提出会社の状況】	7
1 【株式等の状況】	7
2 【役員の状況】	8
第4 【経理の状況】	9
1 【四半期連結財務諸表】	10
2 【その他】	23
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】	24
四半期レビュー報告書	巻末
確認書	巻末

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年2月13日

【四半期会計期間】 第50期第3四半期(自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日)

【会社名】 東京エレクトロン株式会社

【英訳名】 Tokyo Electron Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹 中 博 司

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(5561)7000

【事務連絡者氏名】 経理部長 小 俣 良 二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(5561)7000

【事務連絡者氏名】 経理部長 小 俣 良 二

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次	第49期 第3四半期 連結累計期間	第50期 第3四半期 連結累計期間	第49期
会計期間	自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日	自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日	自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日
売上高 (百万円)	455,514	358,511	633,091
経常利益 (百万円)	46,720	8,805	64,046
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△) (百万円)	27,412	△936	36,725
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	21,559	3,099	36,953
純資産額 (百万円)	583,143	592,330	598,602
総資産額 (百万円)	769,213	753,598	783,610
1株当たり四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△) (円)	153.06	△5.23	205.04
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益 (円)	152.82	—	204.72
自己資本比率 (%)	74.3	77.0	74.9

回次	第49期 第3四半期 連結会計期間	第50期 第3四半期 連結会計期間
会計期間	自 平成23年10月1日 至 平成23年12月31日	自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日
1株当たり四半期純利益 又は四半期純損失(△) (円)	4.21	△39.22

- (注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 3 第50期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」に加え、重要性が高まったと認識した事項は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。また、重要事象等は存在しておりません。

企業買収による影響

当社グループは、事業戦略の一環として、新たな事業領域への進出、新技術・ビジネス基盤の獲得、既存事業の競争力強化などを目的とした企業買収を実施することがあります。具体的な実施にあたっては入念な調査・検討を行っております。しかしながら、買収後に当初期待した成果が十分に得られなかった場合には、当社グループ業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第3四半期連結累計期間においては、中国をはじめとする多くの新興国の成長率鈍化や欧州の債務問題、あるいは米国の歳出削減などによる先行きに対する懸念から、日本を含めた世界経済は総じて緩やかな成長に留まりました。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業においては、パソコン用新型基本ソフト発売によっても需要の喚起に結びつかず、パソコン販売台数は前年度割れとなりました。また、市場の牽引役であるスマートフォンも、先進国では既に広く普及が進んだことから年初に期待されたほどには伸びず、電子部品市況全般として低調に推移しました。

このような状況のもと、当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高3,585億1千1百万円(前年同期比21.3%減)、営業利益53億3千6百万円(前年同期比87.6%減)、経常利益88億5百万円(前年同期比81.2%減)、また、四半期純損失は9億3千6百万円(前年同期は274億1千2百万円の四半期純利益)となりました。

当第3四半期連結累計期間のセグメントの業績は、次のとおりであります。

なお、セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益に対応しております。

① 半導体製造装置

パソコン販売回復の兆しは見えずパソコン用DRAMは不振が続き、スマートフォンやタブレットPC向けのモバイル用DRAMやフラッシュメモリーの需要の伸びも鈍いことから、メモリーを中心とした半導体メーカーの生産調整は続いており、増産設備投資までには結びついていない状況です。一部のロジック系半導体向け先端設備投資は継続されたものの、半導体製造装置市場は全般的に調整局面が続いております。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の売上高は、2,827億5千1百万円(前年同期比16.8%減)、セグメント利益は336億2千6百万円(前年同期比47.4%減)となりました。

② FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル)製造装置

中小型パネルを中心に一部の高機能液晶パネルは伸びているものの、液晶パネルメーカーの生産調整は続いており、液晶パネル用製造装置の需要は低調に推移しております。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の売上高は、139億1千2百万円(前年同期比73.9%減)、セグメント損失は53億8千9百万円(前年同期は35億5千5百万円のセグメント利益)となりました。

③ 電子部品・情報通信機器

電子部品事業においては、デジタル家電関連製品及び産業機器関連製品の需要が停滞し、景気に対する不安感から国内ではIT投資を控える傾向が見られ、情報通信機器関連の販売も低調でした。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の売上高は、621億4千5百万円(前年同期比1.2%減)、セグメント利益は8億6千1百万円(前年同期比47.5%減)となりました。

④ その他

当セグメントの当第3四半期連結累計期間の売上高は、83億9千9百万円(前年同期比25.6%減)、セグメント利益は10億7百万円(前年同期比26.2%減)となりました。

(2) 財政状態の分析

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ983億5千万円減少し、5,087億円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金の減少698億1千8百万円、有価証券に含まれる短期投資の減少267億9千万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から78億8千3百万円増加し、1,347億6千8百万円となりました。

無形固定資産は、のれんの増加541億6千9百万円などにより、前連結会計年度末から556億9千1百万円増加し、603億9千5百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から47億6千3百万円増加し、497億3千5百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から300億1千1百万円減少し、7,535億9千8百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ262億9千7百万円減少し、984億9千6百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の減少159億3千1百万円、前受金の減少91億3千5百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ25億5千8百万円増加し、627億7千2百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ62億7千2百万円減少し、5,923億3千万円となりました。主として、四半期純損失9億3千6百万円を計上したことによる減少、前期の期末配当48億3千7百万円及び当期の中間配当44億7千9百万円の実施による減少、円安の影響による為替換算調整勘定の増加45億1百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は77.0%となりました。

(3) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、548億5千9百万円であります。

なお、当第3四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(4) 従業員数

当第3四半期連結累計期間における連結会社の従業員数は、前連結会計年度末に比べ1,484人増加し、12,168人となりました。主な要因は、企業買収等により「半導体製造装置」セグメントにおいて720人、「FPD/PV製造装置」セグメントにおいて464人増加したこと等によるものであります。

なお、従業員数は就業人員数であります。

(5) 生産、受注及び販売の実績

① 生産実績

当第3四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(百万円)	前年同期比(%)
半導体製造装置	253,870	△23.0
F P D / P V 製造装置	9,663	△79.0
合計	263,534	△29.8

- (注) 1 金額は、販売価格によっております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(百万円)	前年同期比(%)	受注残高(百万円)	前年同期比(%)
半導体製造装置	234,282	△29.3	142,654	△35.2
F P D / P V 製造装置	14,588	△7.2	23,298	△16.5
電子部品・情報通信機器	61,838	△1.1	14,051	△6.4
その他	305	△1.6	—	—
合計	311,014	△24.1	180,004	△31.6

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当第3四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(百万円)	前年同期比(%)
半導体製造装置	282,723	△16.8
F P D / P V 製造装置	13,912	△73.9
電子部品・情報通信機器	61,570	△0.5
その他	305	△1.6
合計	358,511	△21.3

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	300,000,000
計	300,000,000

② 【発行済株式】

種類	第3四半期会計期間末現在 発行数(株) (平成24年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成25年2月13日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	180,610,911	同左	東京証券取引所 (市場第一部)	株主としての権利内容に 制限のない、標準となる 株式であり、単元株式数 は100株である。
計	180,610,911	同左	—	—

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成25年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成24年12月31日	—	180,610,911	—	54,961,191	—	78,023,165

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成24年9月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 1,435,100	—	「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおり
完全議決権株式(その他)	普通株式 179,047,500	1,790,475	同上
単元未満株式	普通株式 128,311	—	—
発行済株式総数	180,610,911	—	—
総株主の議決権	—	1,790,475	—

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成24年9月30日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 東京エレクトロン株式会社	東京都港区赤坂五丁目3番1号	1,435,100	—	1,435,100	0.79
計	—	1,435,100	—	1,435,100	0.79

(注) 当第3四半期会計期間末の自己株式数は、1,427,121株であります。

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間（平成24年10月1日から平成24年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】
 (1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	35,834	49,191
受取手形及び売掛金	150,305	80,487
有価証券	211,790	185,000
商品及び製品	101,789	97,391
仕掛品	35,104	35,252
原材料及び貯蔵品	12,575	14,650
その他	61,026	47,503
貸倒引当金	△1,376	△775
流動資産合計	607,050	508,700
固定資産		
有形固定資産	126,885	134,768
無形固定資産		
のれん	—	54,169
その他	4,703	6,225
無形固定資産合計	4,703	60,395
投資その他の資産		
その他	48,819	53,472
貸倒引当金	△3,848	△3,737
投資その他の資産合計	44,971	49,735
固定資産合計	176,560	244,898
資産合計	783,610	753,598
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	46,986	31,055
製品保証引当金	8,903	8,482
その他の引当金	9,077	3,532
その他	59,826	55,426
流動負債合計	124,794	98,496
固定負債		
退職給付引当金	54,646	56,032
その他の引当金	619	567
その他	4,947	6,171
固定負債合計	60,213	62,772
負債合計	185,007	161,268

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	471,186	460,911
自己株式	△9,747	△9,611
株主資本合計	594,422	584,283
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,575	2,927
繰延ヘッジ損益	△51	△79
為替換算調整勘定	△11,157	△6,656
その他の包括利益累計額合計	△7,633	△3,808
新株予約権	1,156	1,298
少数株主持分	10,656	10,556
純資産合計	598,602	592,330
負債純資産合計	783,610	753,598

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
 【四半期連結損益計算書】
 【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)
売上高	455,514	358,511
売上原価	300,532	244,622
売上総利益	154,981	113,889
販売費及び一般管理費		
研究開発費	59,872	54,859
その他	52,155	53,692
販売費及び一般管理費合計	112,027	108,552
営業利益	42,953	5,336
営業外収益		
受取利息	535	1,022
為替差益	1,089	—
その他	2,426	2,924
営業外収益合計	4,052	3,947
営業外費用		
為替差損	—	227
その他	285	251
営業外費用合計	285	478
経常利益	46,720	8,805
特別利益		
固定資産売却益	13	930
償却債権取立益	1,437	—
その他	171	—
特別利益合計	1,622	930
特別損失		
固定資産除売却損	225	91
災害による損失	※1 938	—
関係会社整理損	—	133
組織再編費用	—	132
その他	1,199	29
特別損失合計	2,363	386
税金等調整前四半期純利益	45,979	9,349
法人税等	18,252	7,916
過年度法人税等	—	※2 2,194
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	27,726	△760
少数株主利益	313	175
四半期純利益又は四半期純損失(△)	27,412	△936

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失 (△)	27,726	△760
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,249	△643
繰延ヘッジ損益	6	△34
為替換算調整勘定	△4,923	4,539
その他の包括利益合計	△6,167	3,860
四半期包括利益	21,559	3,099
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	21,275	2,888
少数株主に係る四半期包括利益	283	211

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
(1) 連結の範囲の重要な変更 該当事項はありません。
(2) 持分法適用の範囲の重要な変更 該当事項はありません。
(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更 該当事項はありません。

【会計方針の変更等】

当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 これによる損益に与える影響は軽微であります。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
税金費用の計算 当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
※1 災害による損失	東日本大震災及びその余震の影響による復旧工事費用等であり ます。	—————
※2 過年度法人税等	—————	当社は、平成18年3月期から平成23年3月期までの6年間における当社と米国及び韓国の子会社との取引について、移転価格税制に基づく更正通知を受領しました。当社はこの処分を不服として当局に対し異議申立書を提出し、今後、二重課税防止の観点から租税条約に基づく相互協議の申し立てを行う予定です。なお、相互協議により二重課税の排除が見込まれるため、過年度法人税等には両国との法人税率差による差額及び追加納税に伴う付帯税額の合計額を計上しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
減価償却費	17,014百万円	18,426百万円
のれんの償却額	—	1,407百万円

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)

1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成23年5月13日 取締役会	普通株式	13,608	76	平成23年3月31日	平成23年5月27日	利益剰余金
平成23年10月28日 取締役会	普通株式	9,493	53	平成23年9月30日	平成23年12月1日	利益剰余金

2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

3 株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)

1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年5月15日 取締役会	普通株式	4,837	27	平成24年3月31日	平成24年6月1日	利益剰余金
平成24年10月31日 取締役会	普通株式	4,479	25	平成24年9月30日	平成24年12月3日	利益剰余金

2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

3 株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD/PV製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置及び薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

前第3四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高	339,990	53,311	62,888	11,289	467,478	△11,964	455,514
セグメント利益	63,885	3,555	1,640	1,365	70,446	△24,467	45,979

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△24,467百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△18,834百万円であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	F P D / P V 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高	282,751	13,912	62,145	8,399	367,209	△8,698	358,511
セグメント利益又は 損失(△)	33,626	△5,389	861	1,007	30,105	△20,755	9,349

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失の調整額△20,755百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△15,156百万円であります。

3 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

当第3四半期連結会計期間において、FSI International, Inc. (米国)、Magnetic Solutions Ltd. (アイerland)及びOerlikon Solar Holding AG(スイス)の全株式を取得し、連結子会社としました。当該事象により発生したのれんの金額は、「半導体製造装置」セグメントにおいて13,761百万円、「F P D / P V製造装置」セグメントにおいて21,786百万円であります。なお、のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定しております。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

(企業結合等関係)

当第3四半期連結会計期間 (自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日)

取得による企業結合

1 FSI International, Inc.の株式取得

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 FSI International, Inc.

事業内容 半導体製造装置(洗浄装置)の開発・製造

② 企業結合を行った主な理由

FSI International社の製品群を当社グループの洗浄装置事業に加えることによって、ポートフォリオを拡充し、洗浄装置事業を強化するためであります。

③ 企業結合日

平成24年10月11日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

⑤ 結合後企業の名称

TEL FSI, Inc.

⑥ 取得した議決権比率

100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社であるTokyo Electron U.S. Holdings, Inc.による現金を対価とする株式取得のため

(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成24年10月11日から平成24年12月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	19,771百万円
-------	-----------

取得原価	19,771百万円
------	-----------

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれん

11,723百万円

なお、のれん

② 発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額をのれんとして処理しております。

③ 償却方法及び償却期間

効果の発現する期間にわたって均等償却します。

2 Magnetic Solutions Ltd.の株式取得

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Magnetic Solutions Ltd.

事業内容 磁場中熱処理装置の開発・製造

② 企業結合を行った主な理由

将来のキーデバイスとして注目される磁気抵抗メモリ(MRAM)製造用の熱処理装置開発を進めるために、Magnetic Solutions社の強磁場熱処理技術を獲得し、当社技術と組み合わせることにより、当社グループの熱処理装置事業を強化するためであります。

③ 企業結合日

平成24年12月3日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

⑤ 結合後企業の名称

TEL Magnetic Solutions Ltd.

⑥ 取得した議決権比率

100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社であるTokyo Electron Europe Ltd.による現金を対価とする株式取得のため

(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成24年12月3日から平成24年12月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	2,054百万円
取得原価	2,054百万円

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれん金額

2,037百万円

なお、のれん金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定しております。

② 発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額をのれんとして処理しております。

③ 償却方法及び償却期間

効果の発現する期間にわたって均等償却します。

3 Oerlikon Solar Holding AGの株式取得

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Oerlikon Solar Holding AG

事業内容 薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置の開発・製造

② 企業結合を行った主な理由

太陽光パネル製造装置事業を発展させるため、薄膜シリコン太陽光パネル製造装置で実績のあるOerlikon Solar社を企業買収し、同社の薄膜成膜技術と当社グループが培ってきた製造装置技術を融合させることにより、同事業を強化するためであります。

③ 企業結合日

平成24年11月26日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

⑤ 結合後企業の名称

TEL Solar Holding AG

⑥ 取得した議決権比率

100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社による現金を対価とする株式取得のため

(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

みなし取得日を平成24年12月31日としているため、当第3四半期連結累計期間には被取得企業の業績は含まれておりません。

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	2,837百万円
取得に直接要した費用	467百万円
取得原価	3,304百万円

(注) 上記のほか、貸付金として23,876百万円を支出しております。

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれん金額

21,786百万円

なお、のれん金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定しております。

② 発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額をのれんとして処理しております。

③ 償却方法及び償却期間

効果の発現する期間にわたって均等償却します。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
(1) 1株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)	153円06銭	△5円23銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益又は四半期純損失(△)(百万円)	27,412	△936
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益 又は四半期純損失(△)(百万円)	27,412	△936
普通株式の期中平均株式数(千株)	179,100	179,175
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	152円82銭	—
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整額(百万円)	—	—
普通株式増加数(千株)	275	—
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	—	—

(注) 当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

第50期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)中間配当については、平成24年10月31日開催の取締役会において、平成24年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額	4,479百万円
② 1株当たりの金額	25円
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日	平成24年12月3日

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成25年2月13日

東京エレクトロン株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 酒井 弘行 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松本 尚己 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京エレクトロン株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成24年10月1日から平成24年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京エレクトロン株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

【表紙】

【提出書類】	確認書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の8第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年2月13日
【会社名】	東京エレクトロン株式会社
【英訳名】	Tokyo Electron Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 竹 中 博 司
【最高財務責任者の役職氏名】	—
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂五丁目3番1号
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 竹中 博司は、当社の第50期第3四半期(自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。